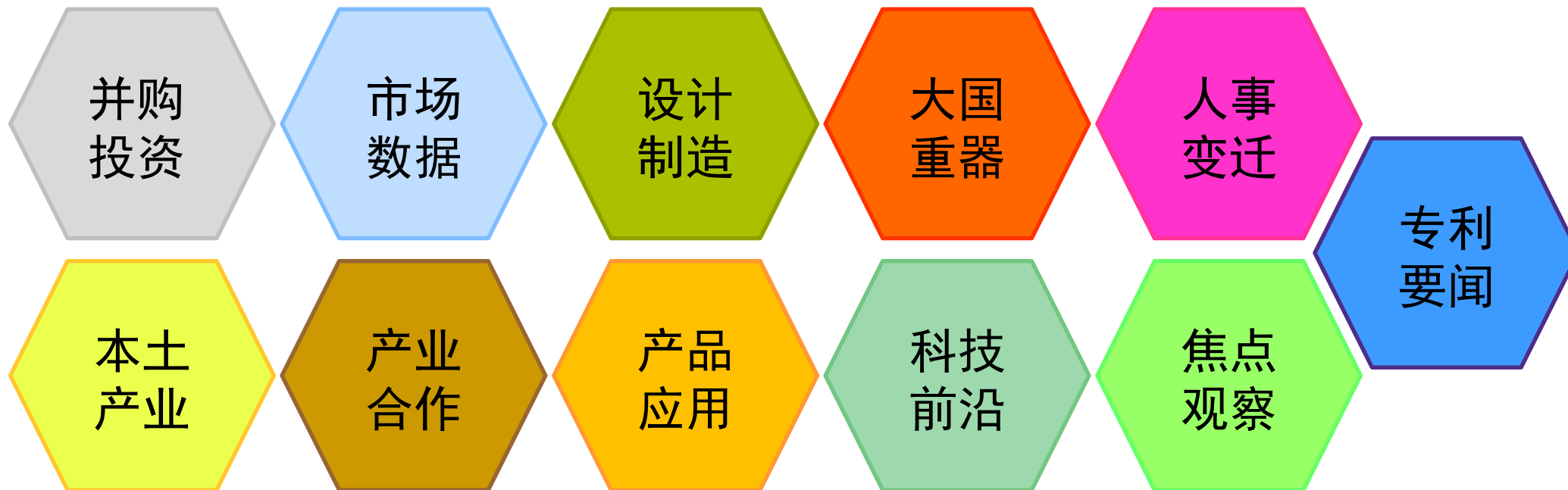


半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0617-2019/0630



专题分类



并购投资

- 重点：
- ① 国产FPGA再获助力，上海安路D轮融资获得大基金领投。
 - ② 大唐电信将所持大唐恩智浦半导体股权转让给全资子公司。
 - ③ 中芯国际以将LFoundry转卖给锡产微芯。
 - ④ 美国安科收购石英MEMS惯性产品全球领先制造商SDI。



| 领域 | 时间 | 事件 | 原因/内容 | 资金(美元) |
|------|------------|---------------------------|---|--------|
| IC设计 | 2019/06/25 | 上海安路完成D轮融资 | 产品研发 。本轮融资将用于上海安路28纳米及12纳米千万门级、五千万门级FPGA、soc FPGA的研发，新产品将主要应用于通讯、工控、显示、消费电子以及人工智能领域，为全球半导体公司提供高性能、低成本、高可靠性的优质FPGA。 | |
| IC制造 | 2019/06/18 | 大唐电信将所持大唐恩智浦半导体股权转让给全资子公司 | 股权调整 。转让完成后，有利于大唐半导体部署和推动公司集成电路设计产业发展，通过资源集中与共享，提升协同效应和市场竞争力。 | 0.12亿 |
| IC制造 | 2019/06/29 | 中芯国际以将LFoundry转卖给锡产微芯 | 原因不明 。 | 1.13亿 |
| MEMS | 2019/06/19 | 美国安科收购石英MEMS惯性产品制造商SDI | 业务增强 。此次收购直接扩大了安科的导航系统产品线规模，使安科成为业内最大的惯性导航产品独立供应商之一。 | 0.22亿 |
| IC测试 | 2019/06/26 | Nanometrics和Rudolph宣布合并 | 强强联手 。这项战略性交易汇集了两个成功和互补的团队和产品组合。Nanometrics的计量组合与Rudolph目前的多元化产品线（包括软件，检测，计量和光刻）具有很强的战略契合性。 | |



本土产业

- 重点：
- ①携手大基金及中科院微电子所，万业企业打造集成电路装备集团。
 - ②紫光2000亿投资四川，成都建3D闪存工厂。
 - ③兴森科技签署30亿元半导体封装产业项目投资合作协议。
 - ④总投资15.2亿，晶瑞股份拟在潜江市投建微电子材料项目。



【万业企业牵头成立中国最全产业链集成电路装备集团】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

6月24日，万业企业发布了一份重磅公告，宣布与中国科学院微电子研究所以及国家集成电路产业基金旗下的芯鑫融资租赁签订合作备忘录，公司将发起并设立集成电路装备集团。新成立的装备集团总投资额达15亿元，其中万业企业与微电子所拟共同出资8亿元，芯鑫租赁为装备集团提供意向性融资额度5亿元。

【紫光在成都建3D NAND Flash工厂】

6月26日，根据紫光官方消息，紫光在四川布局宏大，总投资将超过2000亿元，主要包括服务器芯片、安全芯片、存储芯片和移动通讯相关芯片的研发，建设周期将长达3-5年。目前正在建设的存储3D NAND Flash厂，一期建设完毕后会有一个月10万片产能，三期全部完工后每月产能30万片。

【重庆两江新区启动两大联盟，逐步完善“芯屏器核网”配套体系】

6月24日，重庆两江新区汽车产业联盟、智能产业联盟正式启动。重庆晨报报道指出，智能产业联盟则由京东方重庆区域总经理孙未来担任理事长，该联盟成立后，将进一步整合两江新区智能产业链体系，构建产学研深度融合创新体系，促进资源共享、信息共享，推进智能制造稳步发展，逐步完善两江新区“芯屏器核网”的产业布局，推动人工智能、工业互联网及新一代信息通信技术的合作，促进科研成果转化，持续把智能产业打造成两江新区的支柱产业之一。



【签约金额近300亿元，24个项目落户湖北自贸区】

6月21日，中国自贸试验区发展论坛在武汉举行，湖北自贸试验区三大片区（宜昌片区、襄阳片区、武汉片区）现场签约重大项目24个，总计签约金额近300亿元，涉及产业孵化、保税维修、新能源材料、电子信息、先进制造业、消费电子、医疗器械等多个重要领域。

【美国EDA供应商Silvaco入驻成都】

近日，Silvaco成都技术中心项目签约仪式在成都天府软件园举行，本次签约由成都高新区、矽能科技以及美国Silvaco公司三方共同达成。成都高新区相关负责人表示，此次合作有助于补齐成都高新区半导体产业发展短板、助力成都EDA产业发展，进一步提升成都半导体产业竞争力。

【兴森科技签署30亿元半导体封装产业项目投资合作协议】

近日，兴森科技公告称，公司与广州经济技术开发区管理委员会签署了《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》，项目投资内容为半导体IC封装载板和类载板技术项目，投资总额约30亿元。

【牵手中科院微电子所，厦门海沧再添芯助力】

6月28日，中科院微电子所与厦门海沧区人民政府战略合作框架协议签约仪式暨中国科学院微电子研究所产业合作（海沧）基地揭牌仪式在北京顺利举行。双方将从产业项目投资、区域创新资源集聚、科技项目孵化、产业基金、人才交流与培养等多方面开展深度合作。



【耐威科技拟3亿元参与投资北京集成电路基金】

耐威科技6月17公告，公司拟作为新增有限合伙人，使用3亿元参与投资北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心。北京集成电路基金总募集规模为不低于100亿元。

【晶瑞股份拟在潜江市投建微电子材料项目】

晶瑞股份6月17日公告，公司与潜江市政府、长江基金公司签署投资框架协议。晶瑞股份拟在湖北省潜江市投资建设微电子材料项目，生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。该项目计划总投资额为15.2亿元人民币。

【OPPO、京东、松山湖材料实验室等30个项目开工】

6月17日，东莞举行了推进粤港澳大湾区建设第二批重大项目集中开工暨中子科学城·松山湖材料实验室动工仪式。参加此次二季度集中开工活动的项目共30个，总投资391亿元，年度投资45亿元，包括松山湖材料实验室、OPPO长安研发中心、京东都市科技金融创新中心等项目。



【投资10亿元，第三代半导体项目落户南京】

6月18日，南京百识半导体股份有限公司第三代半导体项目正式落户南京浦口经济开发区。南京百识半导体股份有限公司第三代半导体项目，投资总额10亿元。项目计划在浦口经济开发区投资建设研发中心及生产线，整合海外创新技术与国内产业资源，对第三代半导体碳化硅和氮化镓外延片设计和管件制程等进行研发，产品可广泛应用于信息、新能源发电、新能源汽车、无人驾驶、轨道交通和智能电网等领域。计划项目投产后可实现年产值7亿元。

【航天易联激光气体传感器生产基地投产】

近日，北京航天易联科技发展有限公司筹备建设的激光气体传感器生产基地—亦庄博电新厂房顺利投产。新厂房共建设生产线3条，其中自动化生产线1条，封装生产线2条，厂区配建有先进的研发实验室、校准室等区域，是涵盖激光气体传感器研发、生产、组装、调试、运营为一体的正规化、标准化综合性基地，生产基地的启用将进一步加快科技成果转化。

【新加坡LVG晶圆再生项目落户黄石】

6月18日，新加坡LVG集团晶圆再生项目正式签约落户湖北黄石经济技术开发区。LVG晶圆再生项目，总投资23.13亿元，设备投资额20.96亿元，项目全部投产后，将建成4条晶圆再生生产线，可实现月产40万片的产能规模，年营业收入10.08亿元，年税收1.43亿元。该项目落户黄石后，将为长江存储、中芯国际等国内集成电路企业配套提供测试片、挡控片等晶圆的再生服务。



【中芯绍兴MEMS和功率器件芯片项目封顶】

6月19日，中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目举办主体工程结顶仪式。该项目位于绍兴市越城区皋埠镇，是省重点建设项目和省重大产业项目。项目首期总投资58.8亿元，引进一条芯片年出货51万片的8英寸特色工艺集成电路制造生产线和一条模组年出货19.95亿颗的封装测试生产线，生产线将以微机电和功率器件为核心，定位于面向传感、传输、功率的应用，提供特色半导体芯片，到系统集成模块的代工服务，与中芯国际实现产业链上的差异化互补和协同发展。最终，打造成为国内领先、世界一流的特色工艺半导体代工企业。

【思立微指纹识别芯片设计等20多个集成电路项目落户合肥】

6月18日，99个重点项目在合肥经开区智能装备科技园集中签约，协议投资额约835亿元。在新签约的99个项目中，集成电路、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业达到78个，总投资636亿元，其中集成电路项目超20个。

【我国首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线点火】

6月18日，我国首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线在安徽蚌埠成功点火，进入设备联动调试阶段。该生产线由蚌埠中光电科技有限公司承担，总投资50亿元，占地面积350亩，产品预计于9月实现量产。



【宁夏首个LED照明研发生产项目正式投产】

6月18日，宁夏首个LED照明研发生产项目—宁夏万泰照明科技股份有限公司一期项目在银川经济技术开发区全线投产。该项目共分两期建设，一期项目计划投资5亿元，建设期为5个月，二期项目计划投资6亿元，预计2021年3月31日建设完成。

【10亿元半导体项目落地宿州】

6月27日，宿州市深迪半导体产业园项目开工仪式隆重举行。项目一期投资约10.39亿元，主要从事8英寸集成电路MEMS传感器的生产，可为消费电子及汽车电子市场设计和生产低成本、高性价比、低功耗、小尺寸的商用MEMS陀螺仪芯片。

【海信宣布联合投资5亿成立芯片公司】

6月28日，海信电器股份有限公司与青岛微电子创新中心有限公司共同投资5亿元成立青岛信芯微电子科技股份有限公司。该公司将主要从事智能电视SoC芯片和AI(人工智能)芯片的研发及推广，并以此加速“造芯”攻势。

【隆基股份拟建设咸阳年产5GW单晶组件项目】

6月28日，隆基股份发布公告称，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技与咸阳高新技术产业开发区签订项目投资协议，就公司在咸阳投资建设年产5GW单晶组件项目达成合作意向。隆基股份投资约25.5亿元建设咸阳年产5GW单晶组件项目，建设周期为10个月。

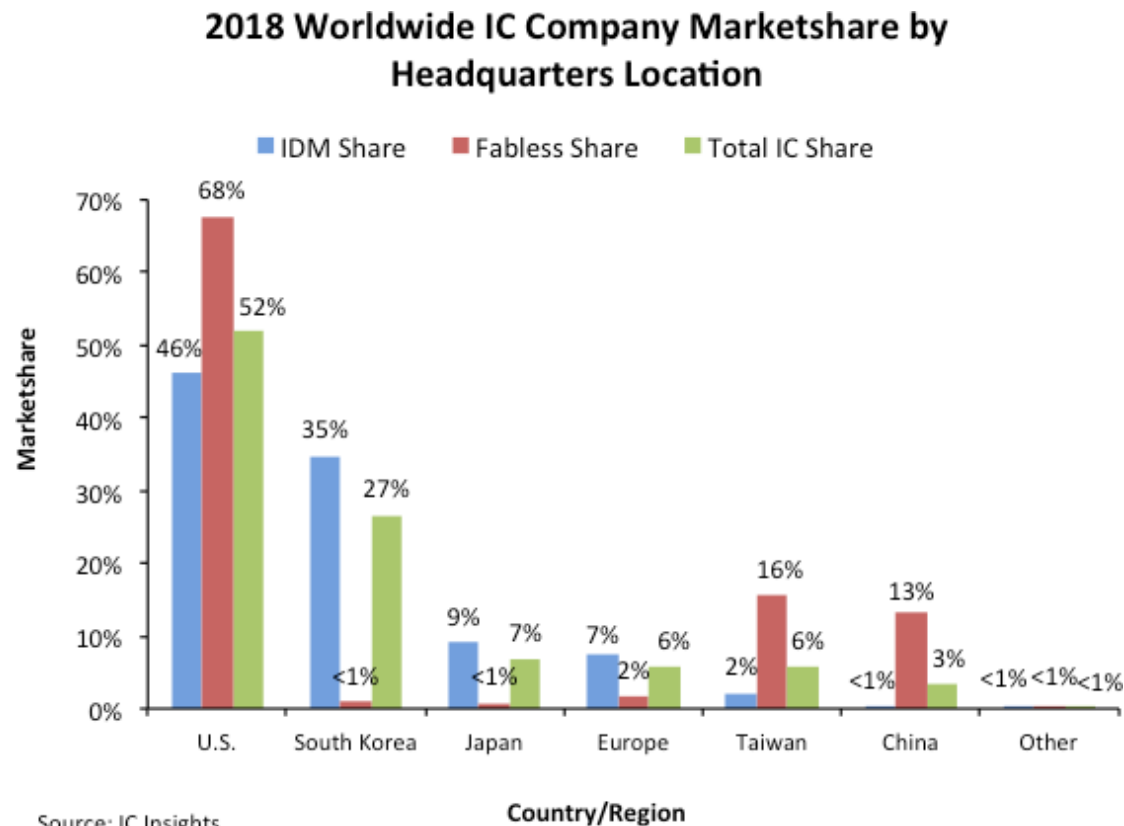


市场数据

- 重点：
- ①2018年全球IC市场份额：美国最高，韩国第二。
 - ②Q1全球十大IC设计排行榜：AMD、NVIDIA营收大幅下滑。
 - ③全球高端手机市场：苹果居首，华为第三。
 - ④华为P30 Pro组件成本16.3%来自美国。



【2018年全球IC市场份额：美国最高，韩国第二】



IC Insight 最新数据显示，2018年美国公司占全球IC市场总量的50%以上，其次是韩国公司，占27%，比2017年增加3个百分点。中国台湾公司凭借其无晶圆厂公司IC销售，与欧洲公司一样，IC销售额占总销售额的6%。



【Q1全球十大IC设计排行榜 AMD、NVIDIA营收大幅下滑】

表、2019年第一季度全球IC设计营收排名

(单位：百万美元)

| Ranking | Company | 1Q19 | 4Q18 | QoQ | 1Q18 | YoY |
|---------|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 博通 (Broadcom) | 4,183 | 4,541 | -7.9% | 4,676 | -10.5% |
| 2 | 高通 (Qualcomm) | 3,722 | 3,739 | -0.5% | 3,897 | -4.5% |
| 3 | 英伟达 (NVIDIA) | 2,110 | 2,404 | -12.2% | 2,790 | -24.4% |
| 4 | 联发科 (MediaTek) | 1,710 | 1,973 | -13.3% | 1,694 | 1.0% |
| 5 | 超威 (AMD) | 1,272 | 1,419 | -10.4% | 1,647 | -22.8% |
| 6 | 赛灵思 (Xilinx) | 828 | 800 | 3.5% | 638 | 29.8% |
| 7 | 美满 (Marvell) | 690 | 780 | -11.6% | 608 | 13.4% |
| 8 | 联咏科技 (Novatek) | 485 | 497 | -2.5% | 357 | 35.8% |
| 9 | 瑞昱半导体 (Realtek) | 416 | 387 | 7.6% | 362 | 14.9% |
| 10 | 新思 (Synaptics) | 334 | 426 | -21.5% | 394 | -15.2% |

备注：

NVIDIA扣除OEM/IP营收

高通仅计算QCT部门营收，博通仅计算半导体部门营收

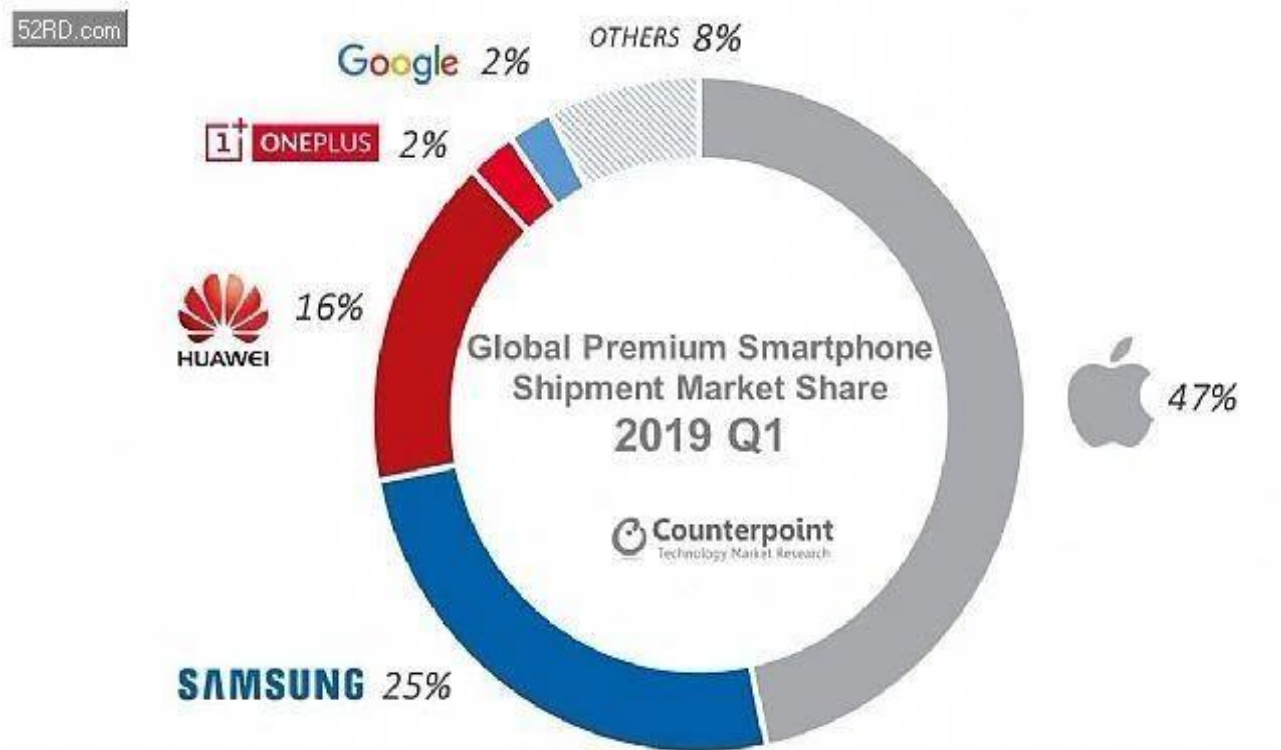
新台币对美金汇率：18Q1为29.32：1；19Q1则为30.83

数据来源：拓璞产业研究院，2019年6月

集邦科技旗下的拓璞产业研究院发布了2019年Q1季度全球TOP10半导体芯片设计公司榜单，除了联发科略微增长1%之外，其他TOP5公司全数衰退，其中NVIDIA跌了24.4%。



【全球高端手机市场：苹果居首，华为第三】



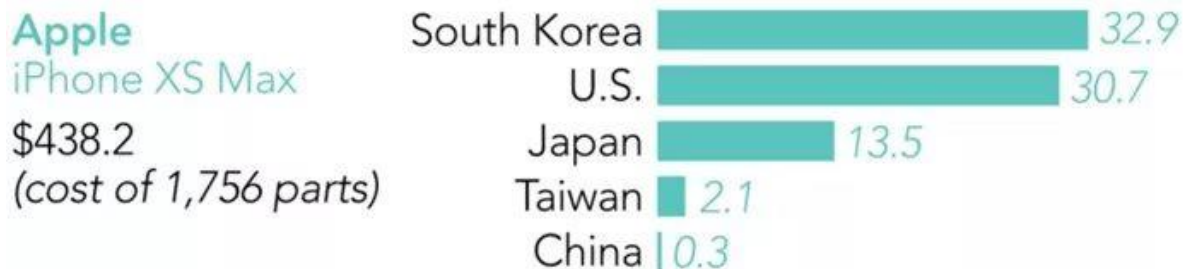
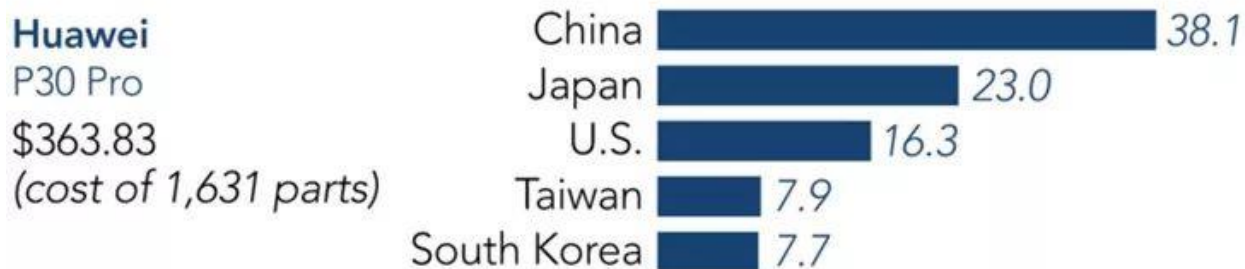
科技市场研究公司Counterpoint发布报告称，2019年头三个月，全球高端智能手机市场萎缩了8%。报告显示，苹果仍然是全球高端手机的主导型厂商，一季度占据了47%的全球份额，排名第二的是老对手三星电子，获得了25%的份额，华为公司排名第三，获得16%的份额。在中国高端手机市场，华为已经超过了苹果。



【华为P30 Pro组件成本16.3%来自美国】

Where Huawei and Apple get their smartphone parts

Dependency on region/territory (percent of total cost)



Source: Fomalhaut Techno Solutions

有外媒对P30 Pro进行了拆解，拆解结果显示虽然来自美国的组件大约有15个，只占该机全部组件的1%，但是1%的组件成本却占了华为P30 Pro总成本的16.3%。相比之下，iPhone XS Max来自中国的零部件供应占比不到1%。



产业合作

- 重点：
- ①SK电讯携手德国电信设立5G合资公司，加码5G发展。
 - ②民生银行与闻泰通讯签署5G项目产融合作协议。
 - ③新思科技和清华大学人工智能合作项目正式启动。



| 领域 | 合作公司/单位 | 目的 |
|------|-----------|---|
| 5G | SK电讯、德国电信 | 联手成立合资公司，专注于核心5G技术的开发。 |
| 5G | 民生银行、闻泰通讯 | 民生银行将通过产融合作支持闻泰通讯5G智能终端研发制造项目。 |
| 人工智能 | 新思科技、清华大学 | 新思科技和清华大学人工智能合作项目正式启动。清华大学与新思科技第二次握手，希望大家在人工智能领域为所有的开发者提供一个优秀的平台。 |



设计制造

- 重点：
- ①英特尔14nm产能不足，秘邀三星为其代工。
 - ②芯恩近况：团队超330人、订购设备超80台、建设三大生产线。
 - ③富士康美国工厂开建。
 - ④兆芯发布两款新一代CPU，赛灵思出货7纳米ACAP，Qorvo推出适合Ka频段和X频段PA。



【英特尔14nm产能不足，秘邀三星为其代工】

韩媒报道，为了解决14nm产能短缺的问题，Intel已经秘密接洽了三星，后者将为其代工代号为“Rocket Lake” CPU。按照规划，Intel要在2021年发布它。

【芯恩近况：团队超330人、订购设备超80台、建设三大生产线】

据青岛信网报道，截止2019年5月，青岛芯恩项目管理和技术团队已签约报到管理及技术人员330人，其中博士20余人，硕士60余人。项目工程8英寸厂筏板基础施工完成90%；12英寸厂筏板基础施工完成93%；测试楼1首层结构完成90%；测试楼2四层结构完成90%；行政中心三层结构完成60%。已订购87台二手生产设备，其中60台已完成翻修。

【赛灵思出货7纳米ACAP】

Xilinx于6月19日宣布，开始出货旗下以台积电7纳米制程所打造的Versal AI Core及Versal Prime系列元件，并提供给多家参与早期试用计划的一线客户。

【富士康美国工厂开建】

6月20日，富士康已经开始为其威斯康星州芒特普莱森特（Mount Pleasant）的工厂浇筑混凝土地基。富士康的美国工厂将于2020年完工，成为北美首家LCD屏幕加工厂。富士康此前表示，工厂建筑面积近100万平方英尺，浇筑混凝土基础的工作将在整个夏季进行。



【Akoustis首批5G移动BAW滤波器送样】

麦姆斯咨询报道，专注于为移动和其他无线应用提供专利体声波（BAW）高频RF滤波器的集成器件制造商（IDM）Akoustis Technologies，近日宣布已为一家数十亿美元规模的Tier-1无线电信客户送样首批5G移动滤波器。此次送样与其最近宣布的一项开发订单有关，该订单旨在为5G频谱寻址手机和其他无线设备开发共存BAW RF滤波器。

【兆芯发布两款新一代CPU】

6月19日，兆芯发布两款新一代16nm 3.0GHz x86CPU，分别命名为KX-6000和KH-30000。KX-6000、KH-30000分别面向PC市场和服务器市场。其中，KX-6000是我国第一款自主设计的主频达到3.0GHz的CPU。

【三星已经越过5G，转向6G研发】

三星电子副董事长李在镕表示，该公司将继续投资包括第六代移动网络和系统半导体在内的未来业务，因为这家韩国科技巨头正面临着迅速变化的全球商业环境，这已经给利润带来了压力。



【Qorvo推出适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

近日，Qorvo宣布，发布两款全新的氮化镓功率放大器系列产品-QPA2212和QPA1022，它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平，且体积更小，因此这两款器件既能提高系统性能，又能降低成本。

【天马微电子拟投资7.4万美元设立印度子公司】

6月22日，显示面板厂商天马微电子发布公告称，为顺应印度业务快速发展的需要，将于全资子公司上海中航光电子有限公司出资7.4万美元在印度设立子公司。



产品应用

- 重点：
- ①寒武纪推出新一代云端AI芯片思元270。
 - ②博士、Bourns分别推出新型MEMS传感器。
 - ③华为Mate 20 X(5G)获国内首张5G终端电信设备进网许可证。
 - ④发布三款新机，分别是nova5i、nova5和nova5 Pro。



| 领域 | 公司/单位 | 产品及特性 |
|------|---------|--|
| AI芯片 | 寒武纪 | 发布了思元270处理器芯片，处理非稀疏深度学习模型的理论峰值性能提升至上一代 MLU100 的 4 倍，达到 128TOPS（INT8）；同时兼容 INT4 和 INT16 运算，理论峰值分别达到 256TOPS 和 64TOPS；支持浮点运算和混合精度运算。 |
| 5G | 华为 | Mate20 X（5G）正式获得5G终端电信进网许可证。 |
| 传感器 | 博世 | 推出了其高性能MEMS加速度计（BMA456）的耳戴式版本—目前全球唯一一款集成了经过优化的耳戴式功能的加速度计产品。 |
| 传感器 | Bourns | 推出高精度MEMS压力传感器，满足高温应用。 |
| 传感器 | 多维科技 | 推出高灵敏度200nA全极TMR磁开关传感器芯片。 |
| 传感器 | 豪威科技 | 推出首款0.8微米4800万像素图像传感器。 |
| 传感器 | Melexis | 推出业界最小的医疗级精度标准的远红外（FIR）温度传感器——MLX90632。该款传感器采用贴片式封装，适用于可穿戴设备以及需要对人体温度进行高准确度测量的临床检测等多种应用。 |
| 智能手机 | 华为 | 发布三款新机，分别是nova5i、nova5和nova5 Pro，定位上分别是低到高。 |



大国重器

重点：①全球超算TOP500发布，中国超算上榜台数仍居第一。
②上海量子科学研究中心揭牌。



【全球超算TOP500发布，中国超算上榜台数仍居第一】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台



6月17日，在德国法兰克福举行的国际超级计算大会发布了全球超算500强最新榜单。根据榜单，中国超算上榜台数仍居第一，美国位居第二，日本、法国、英国和德国依次位列三至六位。这是2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第四次位居第一。



【上海量子科学研究中心揭牌】

6月14日，中国科学院与上海市人民政府在沪签署合作共建上海量子科学研究中心协议。上海量子科学研究中心将聚焦国家重大科技创新战略，结合上海科创中心建设部署，充分发挥双方优势，按照“多方投入、共建共享、融合发展”的原则，以中国科学技术大学上海研究院为基础，联合在沪相关量子科研力量，推进重大基础前沿科学研究、关键核心技术突破和系统集成创新，培育和发展量子信息新兴产业，支撑量子信息领域发展。



科技前沿

重点：①清华大学启动国家集成电路产教融合创新平台建设。
②中科院连续七年位列自然指数全球首位。



【美发布《材料研究前沿：十年调查》，提出9个重点方向】

报告认为材料研究的机遇包括9个方面：金属、陶瓷、玻璃、复合材料和混合材料、半导体及其它电子材料、量子材料、聚合物、生物材料和其他软物质、结构化材料和超材料、能源材料、催化材料和极端环境材料、水、可持续性和洁净技术中的材料研究、移动、储存、泵送和管理热能的材料。

【清华大学启动国家集成电路产教融合创新平台建设】

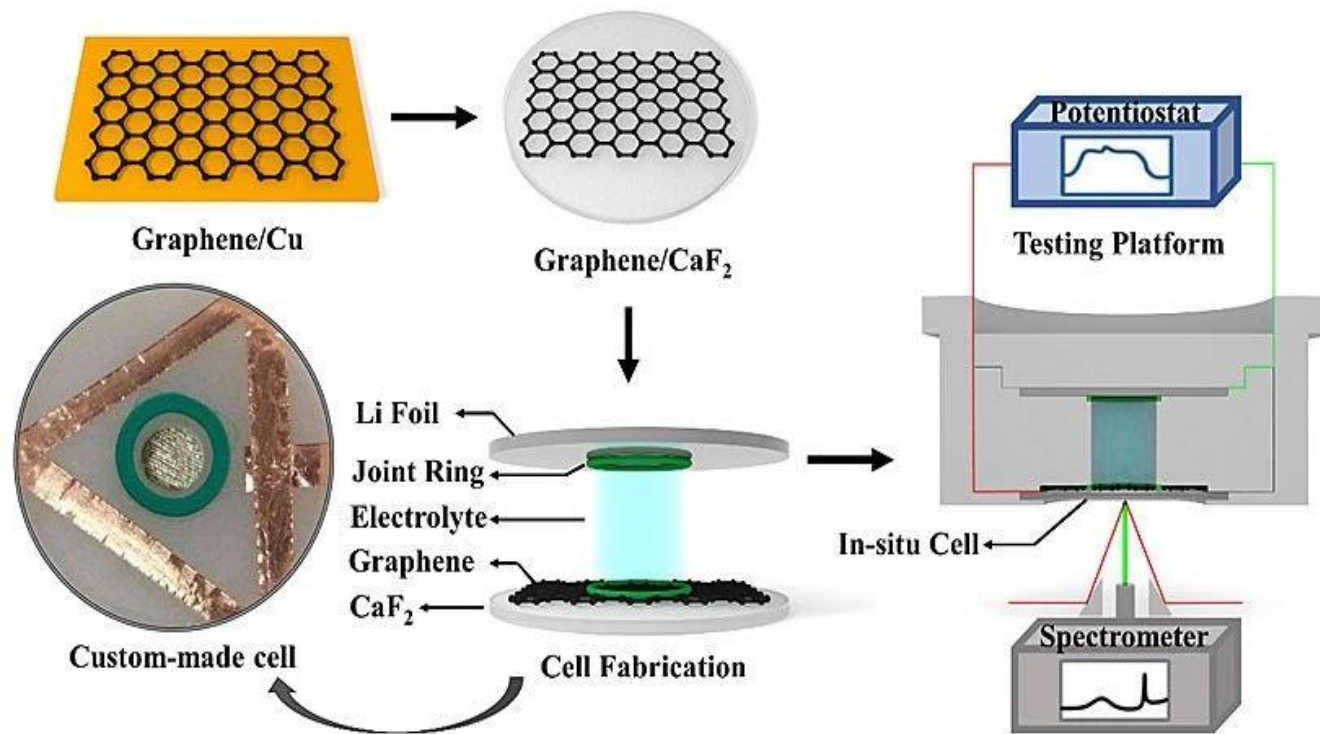
近日，为进一步加大集成电路人才培养力度，清华大学申请承建国家集成电路产教融合创新平台项目，项目可行性研究报告于近日获得教育部批准。该项目将依托清华大学在集成电路领域的优势基础，建设集CMOS逻辑器件与电路、存储器技术、传感器等于一体的京津冀地区人才培养、科学研究、学科建设综合创新平台。

【中科院连续七年位列自然指数全球首位】

6月20日，2019自然指数年度榜单（Nature Index 2019 annual tables）正式发布，中国科学院再次位列全球首位。根据此前发布的自然指数数据，中科院已连续7年位列该排行榜全球第一。



【中科大朱彦武课题组揭示单层石墨烯储锂机制】



原位电化学测试装置示意图。图片来源：
Adv. Mater.

中国科学技术大学朱彦武教授课题组以碳材料的基本结构单元—单层石墨烯作为研究对象，利用原位拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱探究了单层石墨烯电极/电解质界面在电化学循环中的演变过程。通过理解单层石墨烯的锂离子存储机制，为继续深入探索碳-锂作用行为提供了基础，同时为高比表面碳材料的高储锂容量和低首次库伦效率提供了解释。



人事变迁

- 重点：
- ①中芯国际联席CEO梁孟松、赵海军重新当选董事。
 - ②京东方新董事会名单出炉，陈炎顺正式当选董事长。
 - ③郭台铭正式卸任鸿海董事长。



【中芯国际联席CEO梁孟松、赵海军重新当选董事】

6月21日，中芯国际举行了股东周年大会，选举了新一届董事会成员，周子学继续当选董事长，联席CEO赵海军以及梁孟松也继续当选执行董事。

【郭台铭正式卸任鸿海董事长】

6月21日，鸿海集团召开股东大会，郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海股东会，并将于董事会后正式退位。这也就意味着郭台铭将把鸿海这艘“航空母舰”正式移交出去。

【京东方新董事会名单出炉，陈炎顺正式当选董事长】

6月29日，京东方发布公司第九届董事会第一次会议决议公告指出，选举陈炎顺先生为第九届董事会董事长，选举潘金峰先生、刘晓东先生为第九届董事会副董事长。

【MACOM宣布裁员】

6月18日，领先的半导体解决方案供应商MACOM对外宣布，该公司将实施一项重组计划，重组计划包括：永久裁减包括临时员工、全职员工和管理人员在内的约250名员工，占MACOM全部职员的20%。主要包括研发、生产、销售、市场营销以及一般行政职能人员。



焦点关注

- 重点：①中国在四川地震中首次使用5G应急医学救援。
②特朗普：美企可继续向华为出售零部件，不过华为没被移出实体名单。



【四家美国科技巨头发布联合声明】

英媒称，戴尔、惠普、微软和英特尔6月19日发布联合声明，反对美国总统特朗普提出的将笔记本和平板电脑列入对中国商品加征进口关税的名单。

【中国在四川地震中首次使用5G应急医学救援】

在四川省长宁地震救援中，中国首次将5G应急救援系统应用于灾难医学救援。地震发生后，四川省人民医院与中国移动(成都)产业研究院组成的联合救援团队搭乘5G急救车抵达灾区，在长宁县中医院安装了5G基站后，5G技术支持下的远程实时视频会诊随即展开。

【特朗普：美企可继续向华为出售零部件，不过华为没被移出实体名单】

G20峰会中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。特朗普在回答记者问时表示，美国没有把华为从商务部的出口管制黑名单中去除。但允许美国公司向华为出售产品。



专利要闻

重点：①智能手机、摄像头、耳机竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



| 类别 | 公司/单位 | 事件内容 |
|-----|-------|--------------------------|
| 新专利 | 苹果 | 新专利：在设备上如何设置Animoji图片。 |
| 新专利 | 苹果 | 新专利：用触摸手势来控制Apple Watch。 |
| 新专利 | 苹果 | 新专利：为智能手表申请神奇的“表带摄像头”专利。 |
| 新专利 | 苹果 | 新专利：提交远程控制和驾驶汽车专利。 |
| 新专利 | 三星 | 新专利：双屏手机无前置摄像头可自拍。 |
| 新专利 | 三星 | 新专利：电脑屏幕也可以伸长。 |
| 新专利 | 华为 | 新专利：华为Mate X 2或采用向内折叠。 |
| 新专利 | 谷歌 | 新专利：VR耳机冷却系统专利曝光。 |
| 新专利 | 富士 | 新专利：公布可翻转肩屏专利。 |
| 新专利 | LG | 新专利：获得一项带有打孔前置摄像头的手机专利。 |
| 新专利 | AMD | 新专利：申请光线追踪专利：软硬件结合。 |



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

